공겨루의 97-72358 i/2

# ⊙대힌민국목허청(KCR) ⓒ공 개 독 허 공 보(A)

의 L 23/50

제 2658 <del>한</del>

◎국제인자 1997. 11. 7
◎출원인자 1996. 4. 1

⊕공개인호 97-72358 ♥출원번호 96- 9774 성사청구: 있음

母 발 · 당 · 자 · 의 · 영 · 육 · 경기도 설당시 본당구 수내를 또 롯데이코트 132: 1504

교육 원 인 아님산업 무식회사 대표이가 와 이 괴

시물록별시 성공구 성수 2가 280-8 (우: 133-120)

00 범리인 범리사 서 만 ㅠ

(진 2 언)

# ❷ 반도체패키지의 제조빙법 및 구조

### **७** ठ अ

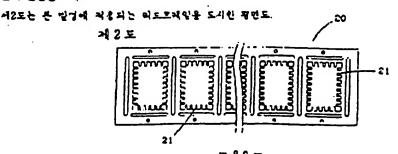
본 발명은 반도세계키지의 제로방법 및 구조에 곤한 것으로, 반도세취의 저면을 의부로 노춘시계 회로통하지 발생되는 영단순의 효과를 국대화하여 피키지의 수명을 면장시키고, 신의성은 합성시킬은 물론, 제키지의 등명 부 의혹에 위치한 리드는 정단하고, 출명부 대주에 위치한 리드는 그 지면은 의부로 노출시의 마디보드에 설팅 시 리도의 거면에서 신호편당을 러도록 할으로서 실장전처을 최소할 수 있는 안모계세키시이다. \*기복터 97-72358 2/2

#### 독히철구의 범위

- 1. 디수의 리트가 청심되고, 상기 다수의 리도 중앙부에는 집합재군이 없는 리드프레임을 역성하는 단계와: 상기 리드프레임의 다수의 리느 중앙부에 인도제집을 위치시켜 와이어본당을 실시하는 단계와: 삼기 와이어본 병관 리트, 인도제집 및 와이어를 의부터 산의 및 부칙으로부터 보호하기 위하여 용당하는 단계와: 상기 단계 후에 운당영역 의자에 위치한 리도를 전단하는 단계로 이루어진 것은 독생으로 하는 반도계계기의 제조방법.
- 2. 개기합에 있어서, 상기 와이어본경우 배를 혹(Vatuum Hole)이 형성된 허디블릭에 반도대칭을 위치시켜 상기 배충 슬로 공기를 떨아들여 반도대칭을 지지 고장하는 것을 무강으로 하는 반도대재키지의 제조방법.
- 3. 거)항에 있어서, 상기 불당단지는 예상 통지자를 사용하여 문당하는 것을 목장으로 하는 반도체제키지의 저 소방법.
- 4. 커]형 또는 3명에 있어서, 역상 부지자를 시용하여 문당하기 전에 문당영역에 단분 형성하여 역상 부지자 가 준데 납치는 것을 받지하는 것을 특징으로 하는 반드자자기자의 거조방법.
- 5. 세1발에 있어서, 삼기 콜럼단자는 물도 집과운드를 사용하여 돌당하는 것을 특징으로 하는 반도록제키지의 기고방법.
- 6. 거3말 또는 5항에 있어서, 생기 역상 봉지자 및 물도 뭐라운드로 물명 후, 150℃ 이상의 고온에서 수시킨 노금시켜 정착시키는 공정을 모임하는 것을 목장으로 하는 반도세파키지의 제조방법.
- 7. 의 1장에 있어서, 상기 반도세대키지의 저면에는 그라인도 (Grinn) 등 실시하여 돌대쉬 (Flash) 등 계거하는 것은 돈장으로 하는 반도계대키시의 서로방법.
- 8. 거1함에 있어지, 생기 물당영역의 의학에 위치한 리도를 접단시 정단은 용이하게 하기 위하여 정단되는 부위의 리도에 노치(Notch)를 형성함은 특징으로 하는 만노제대기지의 거조방법.
- 9. 서년이 의부로 직접 노출되는 반도되었다. 상기 반도체험의 의혹에 위치되고 울당영역을 벗어나지 않으면 지난이 의꾸로 노출되어 지난에서 신호의 입출력이 이루어지는 다수의 리드라: 상기 반도돼워과 리드를 연결시 최주는 와이어와: 상기 반도돼요. 리드 및 와이어를 의부 환경으로부터 보호하기 위하여 울렁된 액상 풍지새 또는 전화은으로 구성된 것을 독점으로 하는 반도세계기지의 구조.
- 10. 여명함에 있어서, 상기 등당된 예상 통기에 및 전파온도는 리도 및 반도체장의 상부로만 동생된 것을 복장으로 하는 반도제폐키자의 구조.
- 11. 제9밖에 있어서, 상기 반도서패키지의 지번에는 둘째서(Flash)의 제거를 위해 그라인도(Grind) 된 것을 특징으로 하는 반도세계키지의 구조
- 12. 제9합에 있어서, 디드프레잉의 나수의 리트 중앙부에는 침발내판이 없는 것을 특징으로 하는 반도체제기 지의 구조. •

표 참고사람 : 최소를된 내용에 의하여 공개하는 것임.

#### 도면의 긴단한 설명



등계목의 97-72358 1/2

## O대힌민국특허청(KCR) ⓒ공 개 특 허 공 보(A)

O L 23/50

제 2658 호

◎국제인자 1997. 11. 7◎출원인자 1996. 4. 1

● 금개번호 97-72358● 출원번호 96-9774

실사정구 : 있습

ው발 및 자 회 영 축 경기도 설날시 본당구 수내동 55 롯데이피트 132·1504

☞ 한 인 아님산업 무식회사 대표이사 활 인 길

식물록별시 설등구 성수 2가 280-8 (우 : 153-120)

야 대리인 범리사 서 만 규

(전 2 년)

8 반도체패키지의 제조방법 및 구조

### **용요** 약

은 발명은 반도체제키지의 제조방법 및 구조에 관한 것으로, 반도계실의 지원을 의부로 노출시켜 피로통착시 발생되는 영단순의 효과를 국대화하여 패키지의 수명을 면장시키고, 신의성을 합성시킬은 불론, 패키지의 등명 부 의혹에 위치한 리드는 것단하고, 골명부 내측에 의지한 리드는 그 저면운 의부로 노출시력 마디보드에 설망 시 리도의 거면에서 신호전당을 러도록 할으로서 실장면적을 최소할 수 있는 안모제제키시이다. **상기록터 97-72358 2/2** 

#### 특허철구의 범위

- 1. 디수의 피드가 형성되고, 상기 다수의 리드 중앙무에는 집합재끈이 없는 리드프레임을 형성하는 난제와: 상기 리드프레임의 다수의 비느 중앙무에 만도제집을 위치시키 와이어본당을 실시하는 단계와; 상기 와이어본 임된 리드, 만도계집 및 와이어를 의꾸의 신의 및 부칙으로부터 보호하기 위하여 용당하는 단계와; 상기 단계 후에 몰당영역 의자에 위치한 리드를 절단하는 단계로 이루어진 것은 독성으로 하는 만도계계기의 개포방법.
- 2. 거1항에 있어서, 상기 와이어본정은 배를 용(Vatuum Hole)이 형성된 허디블릭에 빈도재칭을 위치시켜 상기 내용 출로 공기를 빨아들여 반도재칭을 지지 고정하는 것을 특징으로 하는 반도액패키지의 제조방법,
- 3. 거)할에 있어서, 상기 불당단계는 액상 통지재를 사용하여 본당하는 것을 목장으로 하는 반도계재키지의 제소방법.
- 4. 제1형 또는 3항에 있어서, 핵심 복지자를 시용하여 운당하기 전에 운당성이에 만을 형성하여 예상 봉지재가 가 준비 납치는 것을 방지하는 것을 독장으로 하는 반도제재기자의 제조방법.
- 5. 세1당에 있어서, 상기 물님단자는 물드 집과은드를 사용하여 들당하는 것을 특징으로 하는 반도세계키지의 제조방법.
- 6. 거3말 또는 5항에 있어서, 상기 백상 봉계자 및 골드 청<del>되는</del>드로 용당 후, 150℃ 이상의 고<mark>온데</mark>시 수시킨 노급시켜 정착시키는 공정을 모임하는 것을 독광으로 하는 반도세편키지의 제조합법.
- 7. 커 1성에 있어서, 상기 반도체대키지의 저면에는 그라인도 (Grind) 등 실시하여 중대의 (Flash) 등 세계하는 것은 독생으로 하는 만도제대키지의 제조합법.
- 8. 제1함에 있어서, 생기 물답엉뚝의 의각에 위치한 리드를 접단시 전단은 흥미하게 하기 위하여 전단되는 무위의 리도에 노석(Notch)를 형성함은 투장으로 하는 안노제되기지의 겨조방법.
- 9. 서반이 의부로 직접 노출되는 반도적합과; 상기 반도제합의 의혹에 위치되고 일당영역을 벗어나지 않으며 지번이 의꾸로 노출되어 저번에서 신호의 입출력이 이루어지는 다수의 리트라: 상기 반도체합과 리트를 면접시 지구는 와이어와; 상기 반도체합, 리드 및 와이어를 의꾸 환경으로부터 보호하기 위하여 울명된 약상 통치재 또는 접과운으로 구성된 것을 특징으로 하는 반도색제기자의 구조.
- 10. 제9함에 있어서, 상기 문당된 예상 봉기대 및 전파온트는 리드 및 반도체장의 상부로만 불당된 것을 목정으로 하는 반도제체키자의 구소.
- 1). 제9밖에 있어서, 상기 반도서패키지의 지면에는 통제서(Flach)의 제거를 위해 그라인도(Grind) 된 것을 특징으로 하는 반도세계키지의 구조
- 12 제9합에 있어서, 디드프레일의 나수의 리드 중앙부에는 침발재권이 없는 것을 특징으로 하는 반도제돼의 지의 구조.

표 광고사항 : 귀소군원 내용에 의하여 중개하는 것인.

### 도인의 긴단한 설명

